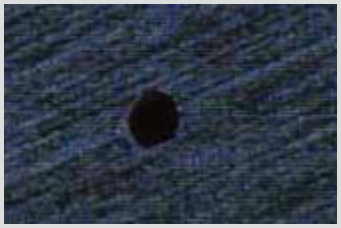
【原因・判断ポイント・発生工程】回路形成用ネガタイプＡＷＦの透明部の汚れによって、露光が遮られて出来たもの（ＡＷＦ作成～ＥＴ工程）

【原因、判断要点、发生工序】由于负像 AWF 的透明部位被玷污，妨碍曝光而引起的（AWF 制作～ ET 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
Stain on a phototool of negative pattern blocks the exposure light to cause the defect.



【コメント】
顕微鏡倍率× 175

【注释】
显微镜倍率 ×175

【Coments】
Magnification: ×175

1-3-2-3　導体貼付ピンホール／导线转移的针孔／ Pinhole by tear and transfer of conductor

【特徴】断線や欠けなどと同居し、重なっていた配線板の接触面の相対位置には、剥ぎ取られた導体が付着している状態の欠け

【特征】开路和针孔等并存，在重叠板件接触面的相对位置上附着从（别的板件）撕下来的导线的针孔。

【Characteristics】This pinhole exists together with opens and pinholes. A piece of torn conductor from a printed board is sticked to the corresponding position on the surface of another printed board stacked with.

【コメント】
左写真がピンホール不合格品、下写真は導体剥離片転写品

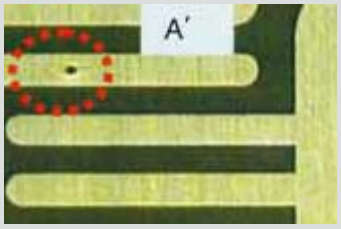
【注释】
左照片是针孔不良，下照片是导线剥离片的转移

【Coments】
Left photo: product with pinhole. Under photo: product with torn-off and transferred conductor pieces.

【原因・判断ポイント・発生工程】間紙を挟まずに配線板を高く重ねたため、自重による過度の負荷が加わり導体同志が圧着して、引き剥がす際に片側の導体が引き剥がされて出来たもの（回路形成後～レジスト塗布前工程）

【原因、判断要点、发生工序】由于没有使用隔纸，板件的堆垛太高，自重过度的负荷致使导线之间互相挤压，当撕开时另一侧的导线被撕下来而引发的（图形转移后～ ET 剂涂布前工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
Many printed boards are stacked without using protection paper. Conductor on a surface of a board sticks to the facing surfaces of the other board because of the excessive load of their own weight. When the stuck boards are separated, a part of conductor on one side of a board is torn off and stick to the facing surface. (After forming conductor pattern - before solder resist application)



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注释】
显微镜倍率 ×

【Coments】
Magnification: ×